



紫外/绿光激光分板机

UV / green laser board splitting machine

该设备主要用于FPC、PCB、铝箔、铜箔等材料的精密切割加工。搭配紫外/绿光激光器，切割无锥度，边缘无残渣，断面光滑，切割边缘基本无裂纹产生，通过精细激光聚焦技术得到直径很小的光斑（直径小于20um的聚焦光斑），实现超精细加工。

- 可实现同等功率下速度、效果最优化，同时进行高效防尘处理，有效减少设备停机清洁维护周期；
- 可实现在线式切割，无人值守，节约人力成本；
- 加工过程无耗材，无刀具磨损；
- 边缘无锥度无残渣，断面光滑，切割边缘基本无裂纹产生，通过精细激光聚焦技术得到直径很小的光斑（直径小于20um的聚焦光斑），实现超精细加工；
- 辅助机器视觉及自动校准，具备高精度图像识别定位功能，操作方便快捷；
- 激光作用点能量聚集，峰值功率高，切割效率高且可以分割各类形状复杂的PCB板。

主要技术参数

加工范围 (mm)	350×350
振镜扫描范围 (mm)	40×40
扫描速度 (mm/s)	≤5000
X、Y定位精度 (mm)	±0.003
X、Y重复定位精度 (mm)	±0.002
平台移动速度 (mm/s)	≤1000
CCD定位精度 (mm)	±0.003 @500像素
最小切割线宽 (mm)	<0.02
最大切割厚度 (mm)	1.0
综合切割精度 (mm)	±0.03
设备外形尺寸 (mm)	1000×1200×1520 (不含三色灯)
设备重量 (kg)	1200

